

证券代码：301285

证券简称：鸿日达

公告编号：2026-040

鸿日达科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设及募集资金正常使用的前提下，拟使用不超过6000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将按时归还至募集资金专户。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1447号《关于同意鸿日达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复同意，公司于2022年9月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,167万股，每股发行价为14.60元，应募集资金总额为人民币75,438.20万元，根据有关规定扣除发行费用7,855.35万元后，实际募集资金金额为67,582.85万元。该募集资金已于2022年9月23日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]215Z0050号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金投资项目情况

公司分别于2022年10月18日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，于2022年11月3日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用人民币5,700万元的超募资金用于偿还银行贷款。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用超募资金偿还银行贷款的公告》（公告编号：2022-004）。

公司分别于2023年8月18日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议，于2023年9月11日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部

分募投项目新增实施地点、实施主体及募集资金专户和变更实施方式的议案》，同意在不改变募投项目的投资方向、投资总额、实施内容的情况下，将原 IPO 募投项目“昆山汉江精密连接器生产项目”中“软硬件设备购置及安装费用、铺底流动资金合计 23,687.01 万元的募集资金”的内容变更由全资子公司东台润田精密科技有限公司（以下简称“东台润田”）利用其现有厂房实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目新增实施地点、实施主体及募集资金专户和变更实施方式的公告》（公告编号：2023-054）。

公司分别于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东会，审议通过了《关于变更部分募投项目、使用超募资金、自有资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司将原 IPO 募投项目“昆山汉江精密连接器生产项目”中剩余“建筑工程费用、工程建设其他费用和预备费用合计 18,566.08 万元的募集资金”的内容全部变更为由“半导体金属散热片材料项目”和“汽车高频信号线缆及连接器项目”使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目、使用超募资金、自有资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-027）。

公司分别于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用人民币 5,700 万元的超募资金永久补充流动资金。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-028）。

公司于 2024 年 9 月 6 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目中的“昆山汉江精密连接器生产项目”预计达到可使用状态的日期延期至 2026 年 3 月 31 日。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-062）。

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目中的“汽车高频信号线缆及连接器项目”“半导体金属散热片材料项目”预计达到可使用状态的日期延期至 2026 年 11 月 30 日。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延

期的公告》（公告编号：2025-028）。

公司分别于2025年12月5日召开第二届董事会第十九次会议，于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司变更原募投项目中“昆山汉江精密连接器生产项目”和“汽车高频信号线缆及连接器项目”的部分募集资金用途，用于开展“光通信设备项目”和“半导体封装高端引线框架项目”（以下简称“半导体引线框架项目”），以进一步推进公司在光通信领域、半导体封装高端引线框架领域的布局，提高募集资金的使用效率与投资回报。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2025-082）。

公司于2026年4月21日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目中的“昆山汉江精密连接器生产项目”预计达到可使用状态的日期延期至2026年11月30日。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-030）。

综上，截至2026年3月31日，公司募集资金投资计划及使用情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目总投资	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额
1	昆山汉江精密连接器生产项目	18,479.24	18,479.24	13,280.14
2	补充流动资金	6,000.00	6,000.00	6,000.00
3	半导体金属散热片材料项目	11,428.17	11,428.17	6,665.72
4	汽车高频信号线缆及连接器项目	3,411.20	3,411.20	1,350.71
5	光通信设备项目	7,864.24	7,864.24	238.51
6	半导体封装高端引线框架项目	11,740.48	1,070.24	0.00
承诺投资项目小计		-	48,253.09	27,535.08
1	半导体封装高端引线框架项目	-	7,929.76	0.00
2	偿还银行贷款	5,700.00	5,700.00	5,700.00
3	补充流动资金	5,700.00	5,700.00	5,700.00
超募资金投向小计		-	19,329.76	11,400.00
合计		-	67,582.85	38,935.08

注1：以上数据未经审计。

注 2：“半导体封装高端引线框架项目”总投资共计为 11,740.48 万元，具体由募集资金 9,000 万元（含超募资金 7,929.76 万元）、鸿科半导体自有资金 2,740.48 万元构成。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于 2025 年 5 月 30 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设及募集资金正常使用的前提下，拟使用不超过 6000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将按时归还至募集资金专户。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-042）。

在上述授权金额及期限内，公司实际用于暂时补充流动资金的首次公开发行股票暂时闲置的募集资金总额为 5,981.43 万元。截至 2026 年 4 月 21 日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，该资金的使用期限未超过董事会审议批准的期限。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-015）。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

鉴于公司募投项目建设需要一定周期，项目资金将根据项目实际进展情况分批逐步投入，募集资金在一定时间内会出现暂时闲置的情形。为提高闲置募集资金使用效率，在保证公司募投项目建设及募集资金正常使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 6000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将按时归还至募集资金专户。

五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

随着公司业务规模的不断扩大，对流动资金的需求不断增加。公司本次使用不超过 6000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，不仅能提高募集资金使用效率，而且可以有效减少公司业务发展所面临的流动资金压力。同时，按同期银行一年期贷款市场报价利率 3.0% 测算，预计一年可为公司节约财务费用约 180 万元（仅为测算数据，不构成公司承诺），符合公司发展要求和全体股东利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。

六、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的说明与承诺

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用；不得通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司在最近十二个月内未进行高风险投资，并承诺在使用募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资。

七、相关审议程序及核查意见

（一）董事会意见

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。董事会认为：在保证募投项目建设及募集资金正常使用的前提下，同意公司使用不超过 6000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将按时归还至募集资金专户。

（二）审计委员会意见

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第二届董事会审计委员会 2026 年第四次例会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。审计委员会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，该事项已经公司董事会和审计委员会审议通过，履行了必要的审议和决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集监管规则》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定，有助于减少财务费用支出，提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途和损害投资者利益

的情形。

综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

八、备查文件

- 1、第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
- 3、东吴证券股份有限公司关于鸿日达科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日